

2024深圳物联网展会

产品名称	2024深圳物联网展会
公司名称	银熊电子信息-专业展会服务
价格	.00/件
规格参数	展会时间:2024.6.26-28 展会地点:深圳国际会展中心（宝安）
公司地址	国际会展中心
联系电话	17674088418 19173144226

产品详情

我们重点邀请全国、省、市、各相关科研单位、消费电子、电源、汽车工业、电子、家用电器、电脑/计算机及部件、显示器、半导体、jungong用品、光电/LED、变频器、机械工业、电子设备、电子元器件、仪器仪表、通信/通讯网络、医疗仪器、风电、太阳能、机箱/机柜、扼流圈、集成电路、晶体管、电工电器、变压器、焊接设备、电力电子器件等企业主管人员到会参观、洽谈。、等行业主管和决策人士到会参观、采购、交流、洽谈。

拟邀请企业

终端企业：华为、三星、OPPO、vivo、小米、中兴、传音、微软、TCL、LG电子、亚马逊、360手机、联想、依偎科技、小辣椒、魅族、努比亚、华硕、海信、京东方、格力、华勤、闻泰、龙旗、京信通信、比亚迪、富士康、长城等。

天线材料相关企业：5G终端天线：安费诺、信维通信、硕贝德、通宇通讯、村田、微航磁电、睿德通讯
LCP材料相关：杜邦、塞拉尼斯、索尔维、宝理塑料、佳胜科技、可乐丽、住友、东丽、普利万、松下
电工、新日铁化学、沃特股份、金发科技、普利特、立讯精密、生益科技、村田、嘉联益、福来盈、台
璩、安缔诺股份MPI材料相关：杜邦、钟渊化学、宇部兴产、韩国SKC、Kolon、瑞华泰、时代新材、丹
邦科技、国风塑业、新纶科技、立讯精密、台虹科技、新扬科、驭能科技、鹏鼎、台郡、东山精密、景
旺电子、比亚迪、精诚达、正业科技PCB材料相关（PEEK、PTFE、PFA等）：索尔维、罗杰斯、泰康尼
克、中兴化成、Park/Nelco、Isola、生益科技、天科乐通讯、沪电股份、深南电路、东山精密、景旺电子
、鹏鼎控股、兴森科技、崇达技术、胜宏科技、依顿电子、博敏电子

导热/EMC材料相关企业：中科纳通、碳元科技、中石伟业、三元电子、中易碳素、鸿富诚、驭能科技、
安洁科技、智动力、飞荣达、领益科技、德镒盟电子、博昊科技、新纶科技、深圳垒石、思泉新材、傲
川科技、3M、莱尔德、固美丽、汉高、贝格斯、罗杰斯、陶氏、道康宁、维酷

手机塑胶/金属/玻璃/陶瓷外壳企业：富士康、比亚迪、长盈精密、通达集团、伯恩光学、蓝思科技、欧
菲光、潮州三环、星星科技、瑞声科技、金振源电子、锐鼎制工、劲胜精密、宜安科技、兴科电子、三
合通发、铠胜集团、格林、捷荣、欣旺达、东方亮彩、银宝山新、深圳致尚科技、中兴新地、东莞晋益

、惠州至精电子、川其五金、科立视、深圳旭荣电子、博恩光学、玳翊光学、昂纳集团、东莞瑞必达等

报道布展: 2024年6月24-25日

展览展示: 2024年6月26-28日

开幕时间: 2024年6月26日

撤展时间: 2024年6月28日

- 1、参展单位详细填写好《参展合同表》并加盖公章，邮寄或传真至组委会；
- 2、组委会收到确认申请表，参展商于5个工作日内将参展费用50%或全款汇入组委会帐户，并将汇款凭证传真至组委会以便查对，否则不予保留预订展位。
- 3、展位安排以“先报名、先交款、先安排”为原则，组委会有权对少量展位予以调整；
- 4、展品运输、展会接待、住宿等事宜将在开展前一个月组委会另行发送《参展商手册》。

导热填料：无机非金属：氧化铝、氧化硅、氧化锌、氮化硼、氮化铝、氮化硅、碳化硅、氧化镁、氧化铍、石墨、炭黑等；金属粉体：铜粉、银粉、金粉、镍粉和铝粉、钠钾合金、铅铋合金、镓铟合金、液态金属原液；化工原料：有机硅、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸树脂、聚酰亚胺、酚醛树脂及化工原料等
电子封装材料：金属：铝、铜（镀铜）、钨/铜、钼/铜、硅/铝、铍/铝、泡沫金属/多孔金属等；橡胶；
陶瓷材料：氮化铝、氧化铝、氧化锆、碳化物、硼化物、氮化物、硅化物；玻璃等导热散热材料热界面材料：导热矽胶布、薄膜/胶带、导热硅胶、导热硅脂、导热凝胶、导热灌封胶、导热垫/碳纤维导热垫、聚合物基复合导热材料，液态金属，导热灌封胶等

陶瓷基板：氧化铝 (Al₂O₃)、氮化铝 (AlN)、氮化硅 (Si₃N₄)、氧化铍 (BeO)；碳化硅 (SiC)、氮化硼 (BN) 等